



株主通信

第18期上半期

自2019年4月1日 至2019年9月30日



株主名簿管理人 事務取扱所

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

電話お問合せ先 0120-288-324 (フリーダイヤル)

中面にお知らせがあります。万一ぬれている場合はよく乾かしてからご覧ください。

群馬大学と共同で、AI 技術によるカスタムLSI 設計環境の構築へ

2019年9月、当社は国立大学法人群馬大学(本部所在地:群馬県前橋市、学長:平 塚 浩士、以下「群馬大学」)と共同研究契約を締結しました。ジーダットの半導体設計 技術と群馬大学のAI技術との共同研究により、設計スキルを組み込んだ、高効率な カスタムLSI設計環境の構築を目指します。

群馬大学大学院理工学府 電子情報部門 高井 伸和 准教授の研究室では、世界で 初めて深層学習と強化学習を向路設計に応用した研究成果があります。またジー ダットは、世界で初めて実用的なセルベース単位 (AnaCell) のアナログ回路設計手 法を実現しています。このセルベース手法に、設計ノウハウを学習させたAIを適用す ることで、ブロックレベルのアナログ回路設計を自動化することが可能となります。

株式数及び株主数 (2019年9月30日現在)

発行可能株式総数 7.800.000株 発行溶株式総数 1.950.200株 株主数 574名

株主メモ

上場市場 東京証券取引所 JASDAO市場 (スタンダード)

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月 配当基準日 3月31日 株式の売買単位 100株

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社

電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 公告掲載方法

http://www.jedat.co.jp/

ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができな

い場合は日本経済新聞に掲載します

会社概要 (2019年9月30日現在)

商号 株式会社ジーダット (Jedat Inc.)

所在地 〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲

代表者 代表取締役社長 松尾 和利

営業開始 2004年2月2日 資本金 760.109.810円

事業内容 電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のための

ソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より当社企業グループに格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。2020年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当第2四半期累計期間において当社は、開発リソースを集中投入して、主力製品SX-Meisterの機能拡張を継続するとともに、当該主力製品をメインにした販促活動の強化にも注力しました。各種展示会・学会に出展し、当社ならびに製品の認知度向上を目指すと共に、製品自身の販売活動に併せて、設計効率や設計品質改善の提案活動も、積極的に展開しました。さらに9月にはプライベートセミナーを開催し、SX-Meisterの導入実績および将来構想を紹介しました。デバイス設計受託分野においては、業容拡張および業務効率化に向けて、その延長線上にあるターン・キー・ビジネスを、本格的に始動しました。また海外においては、販売対象分野を絞り込み、代理店支援を集中的に実施して、顧客層の拡大を図りました。このような活動の一方で、世界的な半導体不況や貿易環境悪化が長期化の様相を示しており、現時点では先行の景況を見通せないため、優先順位が低い予算案件をシフトする事により、固定費の圧縮を行いました。

このような活動の結果、売上高は9億43百万円(前年同四半期比0.8%増)となりました。営業利益は、固定費を圧縮した結果76百万円(前年同四半期比183.8%増)となりました。経常利益は、為替差損等による営業外費用を計上した結果73百万円(前年同四半期比122.4%増)となり、四半期純利益は49百万円(前年同四半期比142.8%増)となりました。

当下半期におきましては、主力製品であるSX-Meisterの更なる機能強化と拡販活動を強化すると同時に、効果的な代理販売製品売上拡大のための販



促活動を行ってまいります。ソリューション・ビジネスにおきましては、設計体制の効率化、EDAソフト受託サービスの拡張に注力いたします。また、海外市場に向けては効率を重視した営業活動を行うことで、売上の拡大に努めてまいります。

株主の皆様には引き続き、変わらぬご理解 とご支援を賜りますよう、どうかよろしくお願 い申し上げます。

代表取纬役社長 松尾 和利

第2四半期累計期間 売上高 (単位:百万円)

		2019年 3月期	2020年3月期		
		実績	計画	実績	前年同期比
事業別売上高	製品	444	488	435	△ 2.1%
	サービス	226	226	235	+ 4.0%
	ソリューション	265	277	272	+ 2.8%
市場別売上高	半導体市場	657	636	616	△ 6.2%
	FPD市場	278	355	326	+ 17.3%
製品区分別 売上高	自社開発製品	689	766	732	+ 6.2%
	代理販売製品	246	225	211	△ 14.4%
売上高合計		936	992	943	+ 0.8%

財務ハイライト (単位:百万円)







